

一、有關就業公司是否屬半導體產業相關公司之認定，概以學員所投入就業之公司係屬

(一)、半導體年鑑廠商名錄所列之公司。

(二)、以經濟部商業司登記

(查詢網址 <http://210.69.121.50/~doc/ce/cesc1110.html>) 明確從事半導體設計、製造、封裝、測試業務,如：

1. 積體電路設計登記項目，包括產品設計服務、積體電路設計研發、積體電路之電腦輔助設計技術服務等。
2. 積體電路製造登記項目，包括從事製造與銷售積體電路以及其他半導體晶圓及裝置等、積體電路之電腦輔助設計技術服務。
3. 積體電路封裝登記項目，包括：
 - (1)從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷。
 - (2)其他電機及電子機械器材製造業(積體電路引線架、球陣列矩陣基板及覆晶基板)
 - (3)其他工商服務業(積體電路之測試)
 - (4)其他電機及電子機械器材製造業(積體電路引線架球陣列矩陣基板及其光罩之製造)
4. 積體電路測試登記項目。
5. 相關系統業者，舉凡半導體技術之相關系統業者，包括資訊、通訊、視訊、光電等相關系統或週邊業者，或提供半導體相關之專利、智財權或技術顧問服務者。
6. 依據 96 年 12 月 28 日工業局「人培計畫養成班非常委員會規劃」之會議記錄，光電半導體(太陽能光電)及 LCD 產業人才培訓，可納入 97 年度半導體人培計畫中辦理